

## RJ45C5E S1U DE4G/Y RL

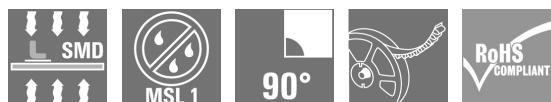
Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



本製品のラインナップは、下記設計を網羅しています：

- 90アングル（水平）および180ストレート（垂直）
- ラッチアップ/ラッチダウン
- THT、THR、SMDはんだプロセス
- 幅広いデザインタイプ、LED内蔵、シールドタブ付き
- パフォーマンスカテゴリ3 から Cat. Cat.6。
- トレイ包装（TY）またはテープ・オン・リール（RL）
- ANSI / TIA-1096-AおよびIEC 60603に準拠したモジュラーRJ45コネクタに対応
- 絶縁耐力  $\geq 1500$  V AC RMS（2250 V ACピーク値）、IEEE 802.3準拠
- IEC 60603に準拠した絶縁耐力  $\geq 1500$  V AC（ピーク値）または  $\geq 1500$  V DC

特性と長所：

- 最大性能に対応する - 40°C から + 85°C の温度範囲拡張
- 30  $\mu$ m 金メッキで耐腐食性を強化
- 0.3mm 以上のスタンドオフによる最適なはんだ付け加工

## 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, RJ45ジャック, Cat. 5e, SMDはんだ接続, 90°, ラッチオプション: 上部, シールドタブ: 6 tabs, 30...80 $\mu$ m Ni / $\geq 30$ $\mu$ m Au, LED: はい, 緑色, 黄色, 極数: 12, Tape
注文番号	<a href="#">2562890000</a>
種別	RJ45C5E S1U DE4G/Y RL
GTIN (EAN)	4050118571912
数量	200 Stück
パッケージ	Tape

## RJ45C5E S1U DE4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	15.7 mm	奥行き (インチ)	0.618 inch
高さ	14.71 mm	高さ (インチ)	0.579 inch
下位バージョンの高さ	13.41 mm	幅	18.8 mm
幅 (インチ)	0.74 inch	正味重量	0.009 g

## システム仕様

LED	はい	
PCB の取り付け	SMDはんだ接続	
はんだピン位置の公差	0.15 mm	
はんだピン寸法	八角形	
はんだ付け工程	リフローハンダ付け, 手動はんだ付け	
カテゴリー	Cat. 5e	
シールド	はい	
シールドタブ	6 tabs	
シールド材質	真鍮	
シールド面	ニッケルメッキ	
ソルダーアイレット穴直径 (D)	0.9 mm	
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	±0.1 mm	
ソルダーピン長 (l)	3.7 mm	
ソルダーピン長 公差	+0.02 / -0.2 mm	
ソルダーピン長 公差	接頭部の下限公差（最小値表示）	-0.2
	プレフィックス付き上限公差（最大値を表示）	+0.02
	公差、単位	mm
ピッチ (mm) (P)	1.27 mm	
ピッチ (インチ) (P)	0.05 "	
プラグイング回数	750	
ラッチオプション	上部	
保護度合い	IP20	
共平面性：	100 μm	
右LEDの色	黄色	
外向きエルボ	90°	
左LEDの色	緑色	
性能カテゴリ	Cat. 5e	
接続方式	SMDはんだ接続	
極当たりソルダーピン数	1	
極数	12	
製品ファミリー	データの最小化 - RJ45モジュージャック	
配線	8コア	
順電圧、最大	2.6 V	
順電圧、最小	1.8 V	
順電流	20 mA	

## 標準

コネクタ規格	IEC 60603-7-51
--------	----------------

## 電気プロパティ

PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合	定格電圧	125 V
定格電流	1.5 A	絶縁耐性	≥ 500 MΩ
耐電圧、接点 / シールド	1500 V DC	耐電圧、接点 / 接点	1000 V DC

作成日 2024/07/04 6:05:50 CEST

## RJ45C5E S1U DE4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 材料データ

絶縁材	PA 9T	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	II
比較追跡指数 (CTI)	≥ 500	絶縁耐性	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 可燃性等級	V-0
接点ベース素材	リン青銅	接点材質	銅合金
接触表面	ニッケル下地金メッキ	プラグ接点の層構造	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	85 °C
動作温度、最小	-40 °C	動作温度、最大	85 °C

## 梱包

パッケージ	Tape	VPE 長	329 mm
VPE幅	329 mm	VPEの高さ	63 mm
テープリール径φ (A)	330 mm	表面抵抗	Rs = 10 <sup>9</sup> - 10 <sup>12</sup> Ω

## 分類

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

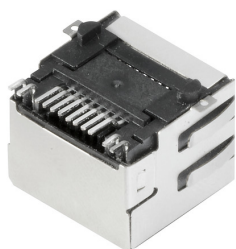
承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Certificate of Compliance</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**RJ45C5E S1U DE4G/Y RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



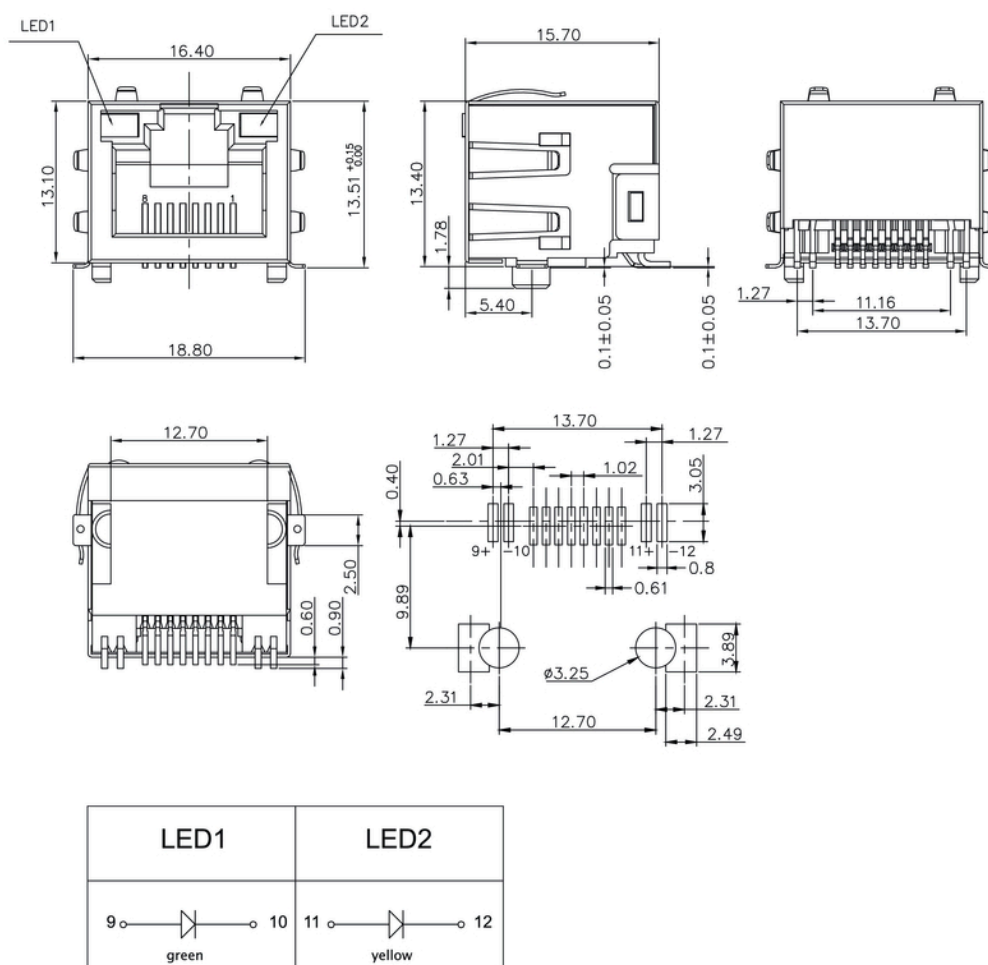
# RJ45C5E S1U DE4G/Y RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 寸法図



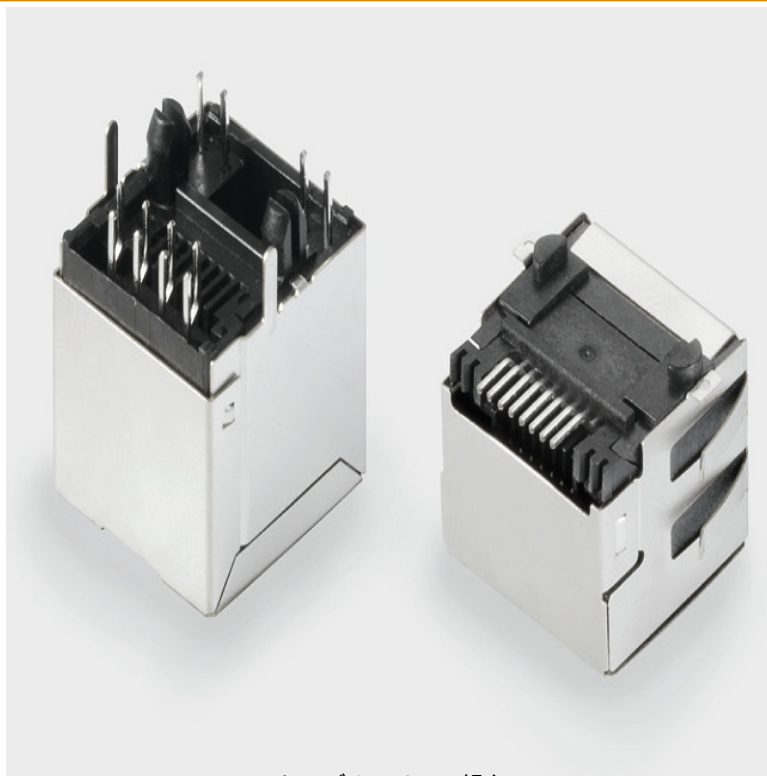
## RJ45C5E S1U DE4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図面

## 製品の利点



トラブルフリーの組立  
短い面取りソルダーピン

RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY									
Packaging	LED	Contact surface thickness	EMI tabs (ground fingers)	Solder Pin length	Direction, latch style	Number of Ports	Assembly on PCB	Performance Category	TY
									RL
									Tray in box (manual assembly)
									Tape on Reel (automated assembly)
LED		Contact surface thickness	EMI tabs (ground fingers)	Solder Pin length	Direction, latch style	Number of Ports	Assembly on PCB	Performance Category	Y/G
									Green/Yellow (standard)
									GY/GY
									Green-Yellow/Green-Yellow
									O/G
Contact surface thickness	EMI tabs (ground fingers)		Solder Pin length	Direction, latch style	Number of Ports	Assembly on PCB	Performance Category	Performance Category	R/O
									Red/Orange
									...
									(further combinations possible)
									without LED
EMI tabs (ground fingers)	Solder Pin length	Direction, latch style	Number of Ports	Assembly on PCB	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	4
									1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
Solder Pin length	Direction, latch style	Number of Ports	Assembly on PCB	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	E
									E = with EMI tabs
									N
									N = without EMI tabs
Direction, latch style	Number of Ports	Assembly on PCB	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	3.2
									3.2 mm
									1.6
									1.6 mm
									D
Assembly on PCB	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	SMD
Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	U
									Horizontal (90°, side entry), latch up
									D
									Horizontal (90°, side entry), latch down
									V
Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Vertical (180°, top entry)
									Y
									Diagonal (45°), latch up
Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	1
									1 Port
									12; 14; ...
									multi ports side by side, Multiport
									multi ports about each other, Multilevel
Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	2; 4; ...
Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	R
									Through Hole Reflow - THR
									Soldering process: Wave or Reflow soldering
									S
									Surface Mount Technology - SMT
Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	T
									Soldering process: Reflow soldering
									Through Hole Technology - THT
									Soldering process: Wave
Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	C5
									Category 5
									C6
									Category 6
									C6A
Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Category 6A
									C5e
									Category 5e
									M
									10/100 Mbit
Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	G1
									10/100/1000 Mbit
									G10
									10 Gbit
									U
Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Performance Category	Unshielded
									MP
									10/100 Mbit with POE
									MP+
									10/100 Mbit with POE+

## 凡例

作成日 2024/07/04 6:05:50 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

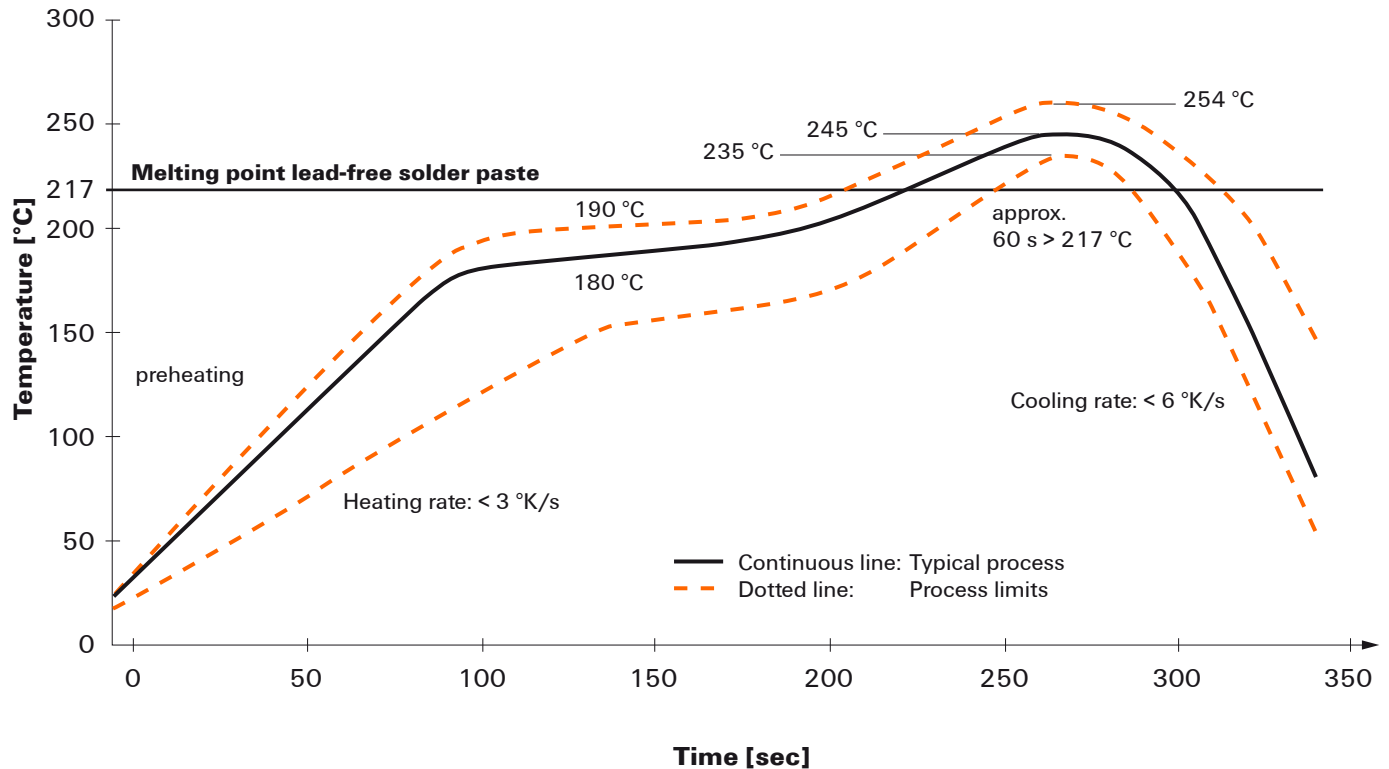
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.